

华润微电子有限公司

投资者关系活动记录表

(2022 年 09 月)

证券简称：华润微

证券代码：688396

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☒ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☒ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）																																										
参与单位名称	09 月 06 日 15:00-16:00 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td style="width: 50%;">易米基金</td><td style="width: 50%;">国华兴益</td></tr> <tr><td>前海人寿</td><td>中华联合</td></tr> <tr><td>吴学东</td><td>波克科技</td></tr> <tr><td>淡水泉</td><td>磐厚动量</td></tr> <tr><td>贤盛投资</td><td>玖阳投资</td></tr> <tr><td>泽源资产</td><td>申万菱信</td></tr> <tr><td>国金基金</td><td>金元顺安</td></tr> <tr><td>东兴基金</td><td>百嘉基金</td></tr> <tr><td>浦银安盛</td><td>德邦基金</td></tr> <tr><td>博时基金</td><td>长江证券</td></tr> </table> 09 月 07 日 15:00-16:00 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td style="width: 50%;">汇丰晋信</td><td style="width: 50%;">上海聆泽</td></tr> <tr><td>建信保险</td><td>上海石锋</td></tr> <tr><td>白犀资产</td><td>中大君悦</td></tr> <tr><td>华安资产</td><td>复星保德信</td></tr> <tr><td>浦银安盛</td><td>国泰君安</td></tr> <tr><td>建信保险</td><td>民生证券</td></tr> <tr><td>淳阳投资</td><td>中信建投</td></tr> <tr><td>睿远基金</td><td>东吴自营</td></tr> <tr><td>博道基金</td><td>幸福人寿</td></tr> <tr><td>东海证券</td><td>上海协国</td></tr> <tr><td>上海域秀</td><td>工银安盛</td></tr> </table>	易米基金	国华兴益	前海人寿	中华联合	吴学东	波克科技	淡水泉	磐厚动量	贤盛投资	玖阳投资	泽源资产	申万菱信	国金基金	金元顺安	东兴基金	百嘉基金	浦银安盛	德邦基金	博时基金	长江证券	汇丰晋信	上海聆泽	建信保险	上海石锋	白犀资产	中大君悦	华安资产	复星保德信	浦银安盛	国泰君安	建信保险	民生证券	淳阳投资	中信建投	睿远基金	东吴自营	博道基金	幸福人寿	东海证券	上海协国	上海域秀	工银安盛
易米基金	国华兴益																																										
前海人寿	中华联合																																										
吴学东	波克科技																																										
淡水泉	磐厚动量																																										
贤盛投资	玖阳投资																																										
泽源资产	申万菱信																																										
国金基金	金元顺安																																										
东兴基金	百嘉基金																																										
浦银安盛	德邦基金																																										
博时基金	长江证券																																										
汇丰晋信	上海聆泽																																										
建信保险	上海石锋																																										
白犀资产	中大君悦																																										
华安资产	复星保德信																																										
浦银安盛	国泰君安																																										
建信保险	民生证券																																										
淳阳投资	中信建投																																										
睿远基金	东吴自营																																										
博道基金	幸福人寿																																										
东海证券	上海协国																																										
上海域秀	工银安盛																																										

	上银基金 09 月 09 日 13:00-17:00 中银国际 野村东方 天风证券 上银基金 上汽金控 山楂树私募 上海宽远 陕西君研投资 摩根大通 瓴仁投资 江西济民可信 海通资管 国信证券 国润投资 敦和资管 东吴证券 德邦证券 翀云投资 LMR PARTNERS 方正证券 天虫资本 中环资产 每日经济新闻 9 月 22 日 10:00—11:30 瑞银资管 海富通 世诚投资 越球投资 建信保险 喜马拉雅资本 海通证券	上海健顺 原点资产 西部证券 奥仕途 上汽顾臻 上海证券 上海聆泽投资 上海景富投资 润晖投资 路博迈基金 雷根基金 华泰证券 海通证券 国泰君安证券 国联证券 东兴基金 东方证券 德邦基金 毕盛投资 上海景富投资 天倚道投资 上海国际信托 华创证券 施罗德投资 东兴基金 东方自营 景领投资 广银理财 First Beijing 信达澳亚
时间	09 月 06 日 15:00-16:00 09 月 07 日 15:00-16:00 09 月 09 日 13:00-17:00 09 月 22 日 10:00—11:30	

地点	华润微电子总部会议室（电话会议） 华润微电子上海总部
上市公司接待人员姓名	李 虹 华润微电子执行董事、总裁 吴国屹 华润微电子董事、财务总监兼董秘 沈筛英 华润微电子投资者关系高级经理
投资者关系活动主要内容介绍	问题一：贵司投资的重庆生产基地 12 吋产线建设情况？产能规划？以及主要关注的市场？ 公司投资的 12 吋产线正在按计划推进实施，预计将于今年年底通线。该项目将有助于增强公司市场竞争优势，进一步奠定公司在国内功率半导体领域的龙头地位。首期产能规划 3 万片/月，产品以 MOS 为主，也有规划 IGBT，终端应用主要针对工控和汽车等附加值较高的市场。 问题二：第三代 SiC 产品目前产品结构及应用如何？SiC MOS 在新能源车上的进展如何？ SiC 上半年销售额主要以 SiC 二极管产品为主，SiC MOS 也已批量销售，主要应用在充电桩、光伏逆变、工业电源、新能源汽车等。SiC 二极管及 SiC MOS 均已有应用到新能源汽车 OBC 上。 问题三：贵司晶圆制造产线是否能生产车规产品，贵司是否有产品进入车规级应用？ 公司 6 吋、8 吋产线目前均符合车规级标准。公司已有多款产品通过车规 AEC-Q101 体系考核。公司 MOSFET、IGBT 产品已进入整车应用并拓展了工业领域的头部客户。同时，公司以国际汽车大厂审核为契机，积极推进汽车电子体系建设，参照车业项目流程，不断进行产品立项研发及 AEC-Q101 体系考核，完善车规级产品体系与供应能力。 问题四：IGBT 产品目前的发展情况怎么样？主要应用场景

有哪些？

2022 年上半年，公司 IGBT 产品销售收入同比增长约 70%，实现批量供应汽车市场头部客户，工业领域销售额同比增加 50%。目前公司 IGBT 产品主要在汽车电子、光伏、UPS、充电桩等应用场景，其中光伏 IGBT 产品已经通过行业头部客户认证并批量供应。

问题五：贵司凭借自有产能和自有产品优势，最近两年产品结构优化幅度很大，请问公司对未来的收入结构是如何规划的？

近几年来，公司产品与方案业务板块在营收中的占比逐年提高，“十四五”期间，公司将围绕自身的核心优势、提升核心技术及结合内外部资源，不断推动企业发展，进一步向综合一体化的产品公司转型。通过持续的产品结构调整及客户结构优化，公司消费类产品收入占比逐步降低，工控和汽车类产品收入占比持续提升。

问题六：公司面板级封装技术在整个产业界来讲算是相对领先的，可否对此技术做更详细的描述？

公司面板级封装最新工艺大幅提升产品良率和可靠性，相关产品已通过 AEC-Q100 验证。公司开发的面板级扇出封装技术，采用载板级 RDL 加工方案，是 Chiplet 封装的基础工艺，不但可以实现低成本 interposer 的加工，也可以完成 HI 系统级封装的最终整合。有效解决了 Chiplet 封装成本高昂的问题，更适用于功率类半导体封装异构集成化。

问题七：公司自五年前就已经开始研发 SiC 器件，虽然当时 SiC 器件受关注度不高，但公司当时就将其作为一块重点产品进行研发；那么站在当前时点看五年后，您是否有一种比

较看好的新型器件或产品？

未来五年会有新产品不断推出，不论是第三代半导体还是硅基产品。短期内，硅基半导体在功率器件上仍然是主流，第三代半导体并不能完全取代硅基半导体，它们各有优点，SiC、GaN 有适合的特殊应用领域，但硅基半导体的应用面还是最广的，而且成本相对低。

新产品的推出不仅要靠晶圆工艺的提升，还有设计能力、封测能力的提升，华润微的发展路径不是追求摩尔定律，而是追求超越摩尔定律，希望通过特色工艺将设计、制造、封测技术结合在一起，最终提供给客户优质的高性能产品。

问题八：关于“两江三地”的战略布局情况？

公司战略区域布局聚焦“长三角+成渝双城+大湾区”，长三角，通过产业升级，实现无锡制造基地整体升级，利用人才优势，做优现有业务；成渝双城，以重庆为基地，围绕功率器件打造研发设计中心、晶圆制造基地、封测基地、外延中心，做大功率器件业务；大湾区，利用市场和应用优势，建立产品及应用中心，全球创新中心。

问题九：公司在传感器领域的整体布局及一些新产品的应用情况如何？

公司在国内 MEMS 制造领域排名第三。目前公司在传感器方面重点做产品化布局，传感器的国际大厂和功率半导体多以 IDM 模式。由于传感器具有种类多、终端应用需求体量参差不齐的特点，国内在该领域的公司中小公司相对多一点。未来华润微会结合自身优势制造资源，通过自有的产品研发，团队引进以及合作投资等方式将 MEMS 业务做大。

问题十：目前 SiC 行业的玩家不仅有传统的功率器件厂商，

还有一些做衬底、外延的厂商也会开始做器件，请问公司如何看待后续器件层面的竞争格局？

在第三代半导体 SiC 方面，华润微专注做产品，同时也非常关注材料端，虽然公司本身不做材料，但会通过投资的方式与上游材料供应商形成战略合作关系，目前公司已经投资了国内行业头部衬底以及外延厂商，保证公司供应链稳定。同时，整个市场处于起步阶段，大家合作共赢的机会很多。

问题十一：公司目前是用硅基做的 GaN 器件，未来是否有计划做 SiC 的 GaN？

行业中目前用硅基做的 GaN 器件称为 GaN 功率器件，而 SiC 衬底的 GaN 产品主要为射频器件，华润微 GaN 产品发展路径中有关于 GaN 射频产品的规划。

问题十二：请问公司在投资方面取得的进展？

2022 年上半年公司围绕整体战略，持续关注外延式扩张机会，在投资方面取得以下进展：公司积极利用国家鼓励政策，成功引入外部投资方对掩膜业务进行混改，建设国内高端的掩模项目；公司完成收购大连芯冠科技有限公司并将其更名为润新微电子(大连)有限公司，为公司在氮化镓功率器件方面的业务奠定基础，是华润微电子做大做强第三代半导体业务、打造华润微新竞争力的重要举措，更为公司 GaN 产品进军电源管理、太阳能逆变器、新能源汽车及高端电机驱动等科技产业打下坚实的基础。截至 2022 年上半年，润科基金共有 41 个项目完成了立项和投决，累计投资 34 个项目，累计投资 13.9 亿元。

问题十三：请问公司在第三代半导体领域发展情况如何？

2022 年上半年，公司在第三代化合物半导体器件领域取得技术和产业化的显著进步。第二代碳化硅二极管 1200V/650V 平台已系列化三十余颗产品，在充电桩、光伏逆变、工业电源等领域实现批量供货；碳化硅 MOSFET 第一代产品已在 650V/1200V/1700V 多个平台系列化多颗产品，上半年公司 SiC 器件整体销售规模同比增长超过四倍。GaN 方面公司充分发挥自有六英寸、八英寸优势，同步推进 D-mode、E-mode 平台建设和产品开发，已具备上量条件，同时公司已于 9 月发布了 GaN 600V、900V 系列化产品并推向市场。

问题十四：请问公司的 MOSFET 产品表现如何？

上半年公司 MOSFET 产品销售收入同比增长 24%。MOSFET 产品以高端应用需求为导向。与应用领域的头部客户加强合作。通过产能结构优化以及特色工艺能力建设，加快平台技术迭代，保持并扩大中低压 MOSFET 产品竞争优势，高压超结 MOSFET 产品收入突破亿元，增长较快。其中先进中低压 MOSFET 和先进高压 MOSFET 的大规模上量，在 5G 通信、充电桩、工业控制(含光伏)及新能源汽车领域实现了规模化销售。

问题十五：公司近期引入很多核心技术人员，能否介绍下公司当前的人才激励政策和人才优化安排？

我司是一家上市公司，过去几十年，我们始终是以市场化、专业化、国际化来运作，在人才激励机制方面我们通过市场化来对标管理，主要有公司股权激励、研发项目激励、项目跟投、利润分享等措施。

问题十六：公司对未来的业绩如何展望？

	集成电路行业有周期性，过去几个季度以来，行业从整体紧缺转变为结构性紧缺。功率半导体相对半导体行业整体周期性较弱，公司认为中国半导体行业长期来看是向好的，市场也有很多机会，公司将通过内部提质增效，持续结构调整，减少周期波动的影响。
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 09 月